

導入年度	H 1 5 年	設備名	ワイヤーボンダー		
メーカー	ウエストボンド社	型 式	7700E	設置室	クリーンルーム

《 概 要 》

プリント基板上に実装した素子の微細配線に使用する機器

《 装置外観 》



《 仕 様 》

最大搭載基板サイズ：100mm 角 × 2mm 厚

ワイヤ径：18 μ m ~ 50 μ m

ボールサイズコントロール機能付

基板温度：室温 ~ 300

吸引固定・治具固定可

《用途例》

- ・ IC と基板を金ワイヤのボンディングによって接合する
- ・ 金の TAB を作成する